

Small Reflow Big Possibilities.

次世代の熱プロセスを 実機で確かめる3日間

第5回 ネプコン ジャパン[秋]

2026.9.9 WED - 11 FRI 10:00 - 17:00

幕張メッセホール2

小間番号 **A9-1**

12インチウエハー対応 小型リフロー炉

UNI-6131



全長2m以下の超コンパクト設計。半導体・電子部品・先端パッケージ分野に対応。SEMI S2/S8、CE認証、GEM通信、クリーンクラス1,000に対応し、熱風循環と遠赤外線を融合したハイブリッド加熱方式で、高い温度再現性と省エネルギー性能を実現します。

ブースに実機を展示いたします！

ブースセミナー

パワー半導体の接合を左右する「熱」の話

～リフロー炉メーカーから見た熱プロセスの考え方～

会期中 1日3回程度開催予定 | 温度プロファイルなどの個別相談も承ります

第5回

ネプコン ジャパン 秋

エレクトロニクス開発・実装展

- 展示会名: 第5回 ネプコン ジャパン[秋]
- 会期: 2026年9月9日(水)～11日(金) 10:00～17:00
- 会場: 幕張メッセ 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
- 小間番号: A9-1(幕張メッセ ホール2)
- 問い合わせ先: アントム株式会社 営業技術本部
- 連絡先: 045-476-3461

※入場には事前の来場登録が必要です。セミナーの開催時刻はブースにてご案内します。

こちらのQRコードから
事前来場登録が可能です。

